

DA 150LE 绝缘型粘接胶 产品数据表

高热稳定性

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 150LE 为单组分、热固性、绝缘型透明固晶胶，专为 LED (GaN) 芯片键合应用而设计。该产品具有优异的粘接性能，同时具备良好的耐热性与耐紫外性能，并具有不渗油特性，适用于对光学与可靠性要求较高的封装结构。DA150LE适用于小尺寸及大尺寸芯片固晶应用，可通过点胶 (Dispense) 或针式转移方式进行施胶。产品已在高温回流焊条件下验证其优异的可靠性与工艺稳定性。

物理特性

产品名称	DA 150LE 绝缘型粘接胶
化学体系	环氧树脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.08 g/cm ³
粘度	5,000 – 10,000 cP
固化材料特性	
玻璃化转变温度 Tg	> 120 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	65
导热系数 (W/mK)	> 0.4
透光率	> 85%
折射率(Kg/mm2)	1.52

剪切强度	1,800 psi
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过
芯片剪切强度	2x2毫米矽晶片(鍍鈀):2.0 2x2毫米鍍金矽晶片(裸銅基底):2.5 2x2毫米鍍金矽晶片(鍍金基底):2.3

推荐固化条件

150 °C 固化 6 – 10 分钟

注：固化时间不包含胶层位置升温至目标固化温度所需的时间。可根据具体工艺条件评估并采用其他固化曲线

储存与保质期

在 -40 °C 条件下、原厂密封容器中保存，保质期为 6 个月。超过建议储存期限可能导致粘度上升。请避免受潮、挥发及外来杂质污染，否则可能影响产品的加工性能。

安全

DA 150LE 为环保型、低毒性材料。在操作和使用过程中仍建议遵循常规工业卫生与安全规范。详细安全信息请参阅产品 SDS (安全数据表)。

包裝

DA 150LE 絕緣晶片黏接膠有售 10cc 30cc包裝規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息，請聯繫YINCAE公司。